

导语：短期阵痛难免。

作者：市值风云 App：小鑫

赛微电子：谷歌光交换芯片核心供应商，出售瑞典资产重注本土晶圆制造

在谷歌（GOOGL.US）Gemini 多模态大模型与 TPU v5p AI 芯片震撼全球的背后，一种名为 MEMS-OCS（光链路交换器件）的关键硬件正在重塑数据中心的传输架构。

权威信息显示，赛微电子（300456.SZ）旗下的瑞典 Silex Microsystems 早已通过工艺验证，并于 2023 年底正式收到批量采购订单，成为谷歌这一核心算力基础设施背后的主要晶圆制造供应商。

这不仅印证了公司在全球 MEMS（微机电系统）代工领域曾经的霸主地位，更将其推向了 AI 算力产业链的最前沿。

一、从导航到芯片的跨越式转型

赛微电子的发展史是一部典型的技术突围史。

公司创始人杨云春拥有深厚的导航专业背景，早年归国创办“耐威科技”，以惯性导航技术起家。

2015 年公司登陆 A 股，当时的核心业务还是惯性导航与卫星导航。2016 年，公司抓住国家集成电路大基金海外并购的机遇，全资收购了全球领先的 MEMS 芯片制造商瑞典 Silex。

这次收购成为公司发展史上的分水岭，使其从一家传统的军工导航企业，摇身一变成为拥有全球顶尖技术的半导体晶圆制造厂商。

经过数年整合，公司确立了“半导体+特种电子”的双主业格局。随着 MEMS

业务的爆发式增长，传统的导航业务占比逐渐降低。

如今，赛微电子已蜕变为一家以 MEMS 芯片制造为核心的高科技企业。公司坚持 “Pure-Foundry” 模式，即纯代工模式，不设计自有产品，专注于为设计公司提供工艺开发和晶圆制造服务。

这种模式避免了与客户的直接竞争，使其能够汇聚全球各细分领域的顶尖客户资源。

二、MEMS 核心逻辑与行业地位

MEMS（微机电系统）是集成电路的一个重要分支，具有极高的技术壁垒。与传统逻辑芯片追求制程微缩不同，MEMS 更强调复杂的微观结构设计与特色工艺的结合。

赛微电子掌握了硅通孔（TSV）、晶圆键合、深反应离子刻蚀等核心工艺，构建了极深的护城河。

在行业地位上，根据 Yole Development 的数据，全球 MEMS 市场规模预计将保持 3.7% 的年均复合增长率，至 2030 年达到 192.0 亿美元。

在纯 MEMS 代工领域，赛微电子旗下的瑞典 Silex 连续多年位居全球第一，与意法半导体、台积电、索尼等 IDM 巨头同台竞技。这种行业龙头的地位，曾赋予赛微电子极高的市场估值与资本关注度。

MEMS 行业的特点是定制化程度高、工艺开发周期长。赛微电子的 “工艺开发 + 晶圆制造” 模式正好契合了这一痛点。

工艺开发业务（NRE）虽然初期营收规模有限，但毛利率高达 40%，且具有极强的客户粘性。一旦产品验证通过转入量产，将带来长期稳定的现金流。

		2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30 ^{NEW}
合计(亿元)		2.45	3.80	4.23	2.28
毛利率					
MEMS晶圆制造(%)		18.18	34.07	33.19	37.12
MEMS工艺开发(%)		49.19	38.67	39.90	42.73
半导体设备(%)		-	19.80	20.21	63.90
其他相关产品(%)		-	3.57	58.59	42.23
合计(%)		31.18	29.22	35.11	40.01

(来源：Choice 终端)

三、地缘博弈下的战略抉择

尽管瑞典 Silex 技术实力雄厚，但随着国际地缘政治形势的复杂化，其经营面临的不确定性显著增加。

瑞典 ISP（战略产品检验局）此前曾否决了瑞典 Silex 向中国子公司进行技术转让的申请，这使得公司原本规划的“瑞典技术+中国市场”的协同效应大打折扣。

面对日益严峻的外部环境，赛微电子在 2025 年做出了重大战略调整：出售瑞典 Silex 的控制权。这一举措虽然短期内会导致并表收入大幅下降，但从长远看，是规避地缘政治风险、回笼资金聚焦本土发展的务实之举。

通过这次资产剥离，赛微电子实现了“退旧进新”。出售 Silex 获得的巨额投资收益，不仅极大改善了公司的资产负债结构，更为其在北京、深圳等地的本土产能建设提供了充足的弹药。

公司未来的重心将彻底转向以北京 FAB3 为核心的国内产线，全力打造自主可控的 MEMS 制造体系。

四、财务上的短期阵痛难免

2025 年三季报集中体现了这一战略转型的财务影响。

公司前三季度实现营业收入 6.8 亿元，同比下降 17.4%。其中，第三季度单季营收 1.1 亿元，同比降幅达 59.2%。这主要是由于瑞典 Silex 在 7 月完成交割出表，不再纳入合并报表范围所致。

■ 赛微电子 – 营收及增速

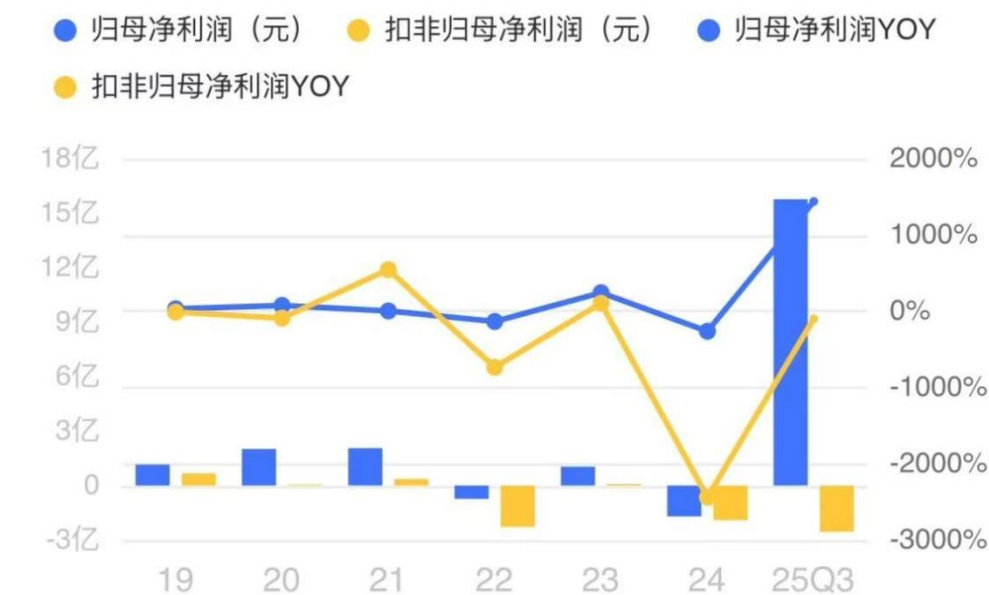
● 营业收入（元） ● 营收YOY



（来源：市值风云 APP）

然而，在利润端，公司却交出了一份惊人的答卷。前三季度归属于母公司股东的净利润达到 15.8 亿元，同比暴增 1438%。这一利润规模远超公司过去十年的总和。

■ 赛微电子 – 净利润



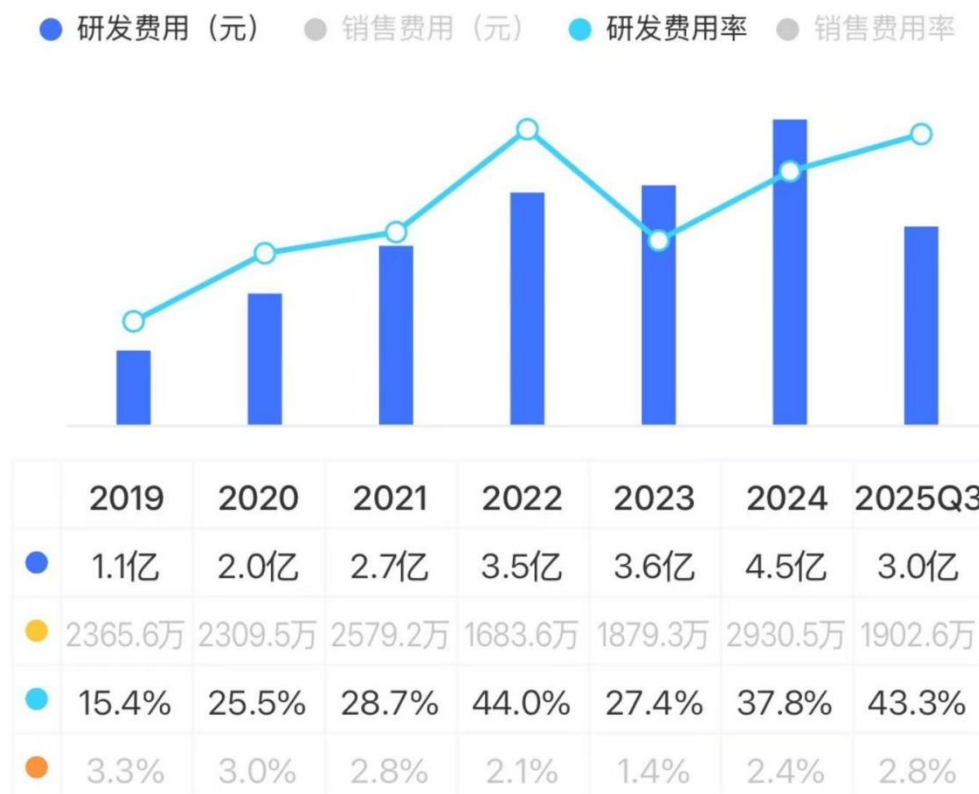
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025Q3
● 归母净利润 (元)	1.2亿	2.0亿	2.1亿	-7336.1万	1.0亿	-1.7亿	15.8亿
● 扣非归母净利润 (元)	6692.6万	557.0万	3585.6万	-2.3亿	815.3万	-1.9亿	-2.5亿
● 归母净利润 YOY	29.8%	74.2%	2.3%	-135.7%	241.2%	-264.1%	1438.0%
● 扣非归母净利润 YOY	-12.6%	-91.7%	543.7%	-735.6%	103.6%	-2439.1%	-99.9%

需要指出的是，这并非来自经营性业务的爆发，而是主要源于出售瑞典 Silex 产生的约 22 亿元的投资收益。

剔除这笔巨额非经常性损益，公司主业仍处于承压状态。一方面，北京 FAB3 产线尚处于产能爬坡期，折旧摊销压力巨大；另一方面，公司保持了极高的研发投入强度。

2025 年前三季度，公司研发费用达 3 亿元，占营收比例处于高位。

赛微电子 – 研发VS销售



在毛利率方面，根据半年报数据，MEMS 晶圆制造毛利率为 37.1%，较上年同期提升 3.9 个百分点；工艺开发毛利率为 42.7%，同比提升 5.2 个百分点，显示出公司核心业务的盈利质量依然稳健。

五、本土化新征程

剥离海外资产后，赛微电子的未来将全系于本土产线的崛起。目前，公司控股的北京 FAB3 产线是国内极少数具备规模量产能力的 8 英寸 MEMS 产线。

虽然短期内由于海外收入的缺失，公司营收规模面临“腰斩”，但国内市场的潜力不容小觑。

随着 5G 通信、自动驾驶、生物医疗等领域的快速发展，对 BAW 滤波器、激光雷达微振镜、硅光子芯片等高端 MEMS 器件的需求正迎来爆发。赛微电子北京产线已实现 BAW 滤波器、微振镜等产品的量产，良率稳步提升。

此外，公司手握重金，并未停止扩张步伐。

公司近期收购了展诚科技控股权及赛莱克斯北京的少数股权，进一步强化了在产业链上下游的布局。充裕的现金（三季度末货币资金总额 22.7 亿，占资产比重 25.5%）使公司在应对行业周期波动时具备了极强的抗风险能力。

赛微电子 - 资产分布(2025Q3)



未分配利润：18.38亿, 2024年度无分红。

从“借船出海”到“造船出海”，赛微电子完成了一次惊险的“空中加油”。虽然短期阵痛难免，但卸下地缘政治包袱、轻装上阵的赛微电子，正在开启国产 MEMS 代工的新征程。